

2024年9月25日

一般社団法人 電子情報技術産業協会  
事業推進部

## JEITA 電子実装技術標準化 活動報告会 2024

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は、当協会の活動に対しまして格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

当協会では、「実装技術標準化専門委員会」を中心に、1997年からはんだ鉛フリー化をはじめ、環境に配慮した実装技術開発活動に取り組み、活動成果は毎年「活動報告会」を開催して広く普及を図って参りました。変革期を迎える今年も、先端的な実装技術の検討結果をご紹介させて頂くべく『JEITA 電子実装技術標準化 活動報告会 2024』（Webによるリモート報告会）を開催致します。

今回は、基調講演にてシステム設計の最新状況についてのご紹介を頂くとともに、経済産業省プロジェクト関連の進捗についての報告、JEITA規格等の標準化動向など、多岐にわたるテーマについてご報告させていただきます。

関係各位におかれましてはご多用中とは思いますが、是非ご参加いただき、忌憚のないご意見、活発なご討論を賜り、各社の事業にお役立て頂けますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬 具

記

日 時：2024年11月1日(金) 13:30~16:40

■ 申込サイト：<https://www.jeita.or.jp/form/custom/369/form>

■ 主 催：実装技術標準化専門委員会

■ 開催形態：オンライン会議システム（WebEX）による報告会

■ 参加費：無料（PDF資料を含む）

■ 申込方法：上記申込サイトからお申し込み下さい。

資料及びオンライン会議（WebEX）参加案内は、開催3日前を目途にご連絡致します。

■ 申込期限：2024年10月28日(月)

■ 事務局：一般社団法人 電子情報技術産業協会 事業推進部（布川・澤田）

E-mail：[tsc4@jeita.or.jp](mailto:tsc4@jeita.or.jp)

以 上

## ■プログラム

〔司会：佐久間 和治 JEITA 実装技術標準化専門委員会副委員長 ㈱村田製作所〕

### 〔挨拶及び全体説明〕

#### 【主催者挨拶】

13:30-13:35 二宮 良次 JEITA 実装技術標準化専門委員会 委員長  
東芝デバイス&ストレージ(株)

#### 【基調講演】

13:35-14:15 「機械設計における MBD 概要と MBE への展開」  
藤沼 知久氏 JEITA 三次元 CAD 情報標準化専門委員会  
㈱東芝 情報システム部 戦略担当

#### 〔METI/IEC プロジェクト〕

14:15-14:40 「複合材料電子回路基板の放熱設計手法に関する国際標準化プロジェクト」  
小野 修平 実装技術標準化専門委員会/サーマルマネジメント標準化 G 委員  
ローム(株)

14:40-15:00 「三次元電子モジュールに関する国際標準化活動のご紹介」  
加藤 義尚 部品内蔵技術標準化研究委員会委員長 福岡大学

15:00-15:20 「IEC61188-6 シリーズ “ランドパターン設計指針” の紹介」  
石橋 広行 実装 CAD ライブラリ&データフォーマット標準化 G 委員  
オムロン(株)

----- (休憩 15 分) -----

#### 〔JEITA 規格・技術〕

15:35-15:55 「はんだ付け試験標準化 G の活動内容紹介」  
長居 秀幸 はんだ付け試験標準化 G 主査 TDK(株)

15:55-16:15 「実装用 MID の 3D・機構構造、バイオマスプラスチックなどの価値と耐熱への  
配慮」  
大谷 修 実装用 MID テクニカルレポート PG 副主査 オムロン(株)

16:15-16:35 「実装用 MID の回路形成技術の価値と接合信頼性への配慮」  
坂本 一三 実装用 MID テクニカルレポート PG 主査 エス・シー・エル

#### 【おわりに】

16:35-16:40 松岡 徹氏 経済産業省 イノベーション・環境局 国際電気標準課 課長補佐  
(電子・情報担当)

※ プログラムは変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。